

基板設計仕様書

基本的には、お客様からの設計仕様を優先することとする。

お客様より指定のない場合は、以下の項目を満足することとする。

No	項目	設計基準	補足
1	設計 CAD ソフト	MAX BOARD	
2	ベース基材	材質:FR-4、板厚:1.6mm	他仕様は別途製造仕様書参照
3	設計最大寸法	500mmx500mm 以下	
4	基板層数	片面、両面、4層、6層、8層、貫通スルーホール	
5	自動挿入機/装着機等の PWB 位置決め基準穴	なし	
6	PWB 位置決め基準穴	なし	
7	PWB 外周及び位置決め基準穴のデッドスペース	なし	
8	ディスクリート挿入部品	手挿入を前提とする	
9	ディスクリート部品のパッドに関する基準	部品メーカー推奨ランド情報に準ずる	
10	挿入ピッチの統一	5mm、10mm、15mm、20mm	部品ピッチに準じる
11	挿入部品の最小隣接間距離	最大部品外形間 1mm	
12	その他特殊部品の自動挿入	なし(手挿入部品最大外形間 1mm)	
13	表面実装部品のパッドに関する基準	部品メーカー推奨ランド情報に準ずる	
14	装着位置決め用認識マーク	なし	
15	チップ部品間の最小隣接間距離	ランド > 部品 ランド間 1mm 部品外形 > ランド 最大部品外形間 1mm	
16	表面実装IC	0.5mm ピッチからは、ランド間全面レジスト開口	
17	品質、信頼性の保証	製造仕様書に準拠する	製造仕様書参照
18	導体の補強	スルホールには、ティアドロップあり	
19	レジストの開口形状	ランド + 0.1mm(全方向)	
20	導体間の最小隣接間距離	0.2mm	製造仕様書参照
21	ミシン目、Vカットに関する基準	製造基準書に準拠する	製造仕様書参照
22	穴径指定基準	製造基準書に準拠する	製造仕様書参照
23	最小パターン幅等の基準	0.2mm	製造仕様書参照
24	部品配置に関する基準	基板端から部品外形線まで 1mm は配置不可	
25	シルク印刷	白色 0.2mm 幅	

2011 年 10 月
マルツエレクトリック株式会社